

# 山东天岳先进科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：天岳先进

证券代码：688234.SH/02631.HK

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 电话调研	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	见附件清单		
时间	2026年3月		
地点	通讯会议		
接待人员	公司 IR		
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分：交流环节的主要问题及回复</b></p> <p><b>问题 1：随着行业向 8 英寸及更大尺寸迈进，请问公司如何看待大尺寸长晶技术壁垒的本质变化？公司在保持技术代差上有哪些核心优势？</b></p> <p>回复：随着衬底尺寸向 8 英寸及以上升级，碳化硅长晶的技术壁垒已从单一尺寸突破，转向高温极端环境下的全流程系统控制。晶体直径每增加 1 英寸，内部热应力呈指数级上升，边缘缺陷、厚度均匀性、微管密度的控制难度非线性提升，对籽晶品质、热场仿真设计、长晶过程动态调控、超精密加工的要求系统性提高，技术壁垒更趋长期化，难以短期复制。</p> <p>公司依托十余年产业化积淀，核心竞争优势体现在三方面。一是籽晶全自研自制，从源头保障大尺寸晶体的成核质量与缺陷控制根</p>		

基。二是掌握高温长晶、缺陷精准抑制、热场自主优化、超精密加工等全链条核心技术，形成闭环技术体系。三是长期规模化量产积累的工艺数据库与参数经验，2025年公司持续优化长晶工艺参数，稳步提升良率与生产效率，构成难以短期复制的产业壁垒，持续巩固并拉大技术领先优势。

**问题 2：除了传统的车规和工业电源，近期 AR 眼镜、先进封装等概念火热。公司在这些新兴领域的技术储备和应用怎样？**

回复：除车规、工业电源等成熟应用外，公司也在积极推动碳化硅材料向 AR 眼镜、先进封装、固态变压器（SST）等新兴领域拓展。碳化硅衬底具备高折射率、低双折射、高导热、耐高温、抗辐射等特性，能够适配上述场景对光学性能或极端环境可靠性的要求。

在 AR 眼镜领域，公司基于高纯度、低缺陷的半绝缘型衬底技术，开展光波导片等光学级产品的研发与客户验证。在先进封装领域，依托碳化硅高导热、低翘曲的特性，布局高端散热中介层相关产品开发。此外，在对耐高压、抗辐射要求较高的固态变压器场景，公司也在持续探索应用潜力。

目前，公司正有序推进各项技术验证工作。碳化硅材料在新兴场景中的独特优势逐步显现，公司将持续拓展应用边界，将其作为培育新增长点的重要方向。

**问题 3：公司近期提及的马来西亚基地建设。请问这一举措的核心战略考量是什么？**

回复：公司推进马来西亚基地建设，核心是顺应全球半导体产业链区域化布局趋势，匹配海外核心客户的供应链多元化与本地化需求，进一步提升全球化供应韧性与风险分散能力。

该基地是公司完善“国内为主、海外补充、多地协同”产能体系的重要组成部分，目前处于前期筹划阶段。建成后将主要聚焦东南亚及欧美市场的产能配套与本地化服务，缩短对海外客户的交付周期，降低跨境物流成本与地缘政治因素带来的供应链风险，同时有助于深化与全球头部客户的长期合作，提升公司在全球碳化硅市场

	<p>的综合服务能力与品牌影响力。</p> <p><b>问题 4:行业迈向平价时代的核心驱动力在于成本控制。在不依赖单纯价格竞争的前提下，公司认为未来碳化硅衬底降本底层逻辑是什么？</b></p> <p><b>回复:</b>公司认为，碳化硅衬底的长期降本不依赖单纯价格竞争，而是以技术迭代与效率提升为核心底层逻辑，主要来自三个维度。</p> <p>大尺寸化结构性降本：通过 8 英寸、12 英寸产品升级，单片衬底可切割的芯片数量成倍增长，从根本上降低单位芯片的衬底成本。</p> <p>全流程工艺优化降本：持续提升晶体生长良率、加工良率与设备稼动率，推进长晶炉等核心设备的国产化替代，以技术进步对冲原材料与能源成本波动。</p> <p>规模化精益制造降本：依托上海、山东等基地的产能逐步释放，摊薄单位固定成本，同时通过精细化运营优化供应链管理，实现全产业链的成本协同。</p> <p>2025 年公司已通过上述措施有效对冲了部分行业价格下行压力，未来随着 8 英寸产能的规模化释放，成本优势将进一步凸显。</p>
附件清单 (如有)	参会机构名单
日期	2026 年 3 月
备注	参加投资者接待活动中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确。

附件：参会机构名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	PICC Asset Mgt (HK)	2	UNION
3	Ping An of China Asset Mgt	4	Cooper Investors
5	Enhanced Investment Product	6	平安基金

7	T. Rowe Price Associates	8	JP Morgan
9	Banque Pictet et cie SA	10	TEMASEK
11	Neuberger	12	Wellington Capital
13	Dymon Asia	14	富国香港
15	Franklin Templeton	16	CLSA
17	银华基金	18	Sumitomo Mitsui
19	正圆私募	20	PAG
21	上海从容投资	22	TOROA
23	彼得明奇私募	24	CORBETS CAPITAL
25	大成基金	26	Oberwels
27	新华资产	28	LyGH Capital
29	华夏基金	30	OVATA CAPITAL
31	摩根基金	32	Polymer Capital
33	招商基金	34	Point 72
35	长城基金	36	BNP PARIBAS Asset mgt
37	嘉实基金	38	Morgan Stanley
39		40	
41		42	
43		44	
45		46	
47		48	
49		50	
51		52	
53		54	
55		56	
57		58	
59		60	
61		62	
63		64	
65		66	
67		68	
69		70	
71		72	

73		74	
75		76	
77		78	
79		80	
81		82	
83		84	
85		86	
87		88	
89		90	
91		92	
93		94	
95		96	
97		98	
99		100	